

证券代码：002916

证券简称：深南电路

### 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-15

<p><b>投资者关系活动类别</b></p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研      <input type="checkbox"/> 分析师会议      <input type="checkbox"/> 现场参观  <input type="checkbox"/> 媒体采访      <input type="checkbox"/> 业绩说明会      <input type="checkbox"/> 新闻发布会  <input type="checkbox"/> 路演活动      <input type="checkbox"/> 其他（_____）         </p>
<p><b>活动参与人员（排名不分先后）</b></p>	<p>           中原证券、中邮证券、中邮创业基金、中银国际证券、中信证券资管、中信证券、中信里昂证券、中信建投证券、中泰证券、中欧基金、中国银河证券、中国人寿资管、中国人保资管、中金公司、浙商证券、招商证券、长盛基金、长城证券、圆方资本、圆信永丰基金、友邦人寿保险、易方达基金、野村国际(香港)、循远资产管理(上海)、兴证证券资管、兴业证券、新华基金、新华资产、香港时代投资、西南证券、西部证券、天弘基金、太平基金、首域盈信资管、拾贝投资管理(北京)、拾贝投资管理（北京）、深圳市智诚海威资产管理、深圳市易同投资、深圳市唯德投资、深圳市辰禾投资、深圳前海浑元资产管理、深圳丞毅投资、申万菱信基金、申万宏源证券、上海证券、上海运舟私募基金、上海申银万国证券研究所、上海盘京投资管理中心（有限合伙）、上海迈维资产管理、上海景领投资管理、上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)、上海国际信托、上海光大证券资管、上海道翼投资管理、山东龙信股权投资管理、瑞士银行香港分行、瑞士银行、鹏华基金、诺安基金、南方基金、摩根士丹利基金（中国）、民生证券、民生加银基金、美林(亚太)、昆仑健康保险、开源证券、九泰基金、交银施罗德基金、建银国际证券、嘉实基金、嘉合基金、惠升基金、汇华理财、华源证券、华西证券研究所、华西证券、华泰证券（上海）资管、华泰证券、华安财保资管、花旗、和谐健康保险、浩成资产管理、海通证券、海富通基金、国信证券、国投证券、国投瑞银基金、国泰基金、国泰海通证券、国盛证券、国融基金、国金基金、国华兴益保险资管、国海证券、光大证券、耕霖（上海）投资管理、格林基金、高盛（中国）证券、高盛(亚洲)有限责任公司、方正富邦基金、敦和资产管理、东证融汇证券资管、东兴基金、东吴证券、东方证券、东北证券、第一上海证券、创金合信基金、财通证券、博裕资本、博时基金、北京泽铭投资、北京市星石投资管理、北京泓澄投资管理、北京宏道投资管理、北京诚旻投资、鲍尔赛嘉(上海)投资管理、百年保险资产管理、Point72HongKongLimited、LOMBARD ODIER (SINGAPORE) LTD.         </p>
<p><b>上市公司接待人员</b></p>	<p>           副总经理、董事会秘书：张丽君；战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；            投资者关系经理：郭家旭         </p>
<p><b>时间</b></p>	<p>2025年4月23日</p>
<p><b>地点</b></p>	<p>网络及电话会议、公司会议室</p>
<p><b>形式</b></p>	<p>网络及电话会议、实地调研</p>

投资者关系  
活动主要内容介绍

交流主要内容:

**Q1、请介绍公司 2025 年第一季度经营业绩情况。**

2025 年第一季度，公司实现营业收入 47.83 亿元，同比增长 20.75%；归母净利润 4.91 亿元，同比增长 29.47%；扣非归母净利润 4.85 亿元，同比增长 44.64%。以上增长主要得益于高速网络通信、算力及服务器相关需求增长，以及汽车电动化/智能化趋势持续深化等市场机遇，公司实现 PCB 业务营收规模增长、产品结构优化，推动利润稳健增长。

**Q2、请介绍公司 2025 年第一季度 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。**

公司在 PCB 业务产品下游应用以通信设备为核心（覆盖无线侧及有线侧通信），重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子（聚焦新能源和 ADAS 方向）等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。2025 年第一季度，公司 PCB 业务通信领域无线侧订单较去年第四季度小幅度回升，有线侧交换机等需求保持增长。数据中心领域订单环比继续增长，主要得益于 AI 加速卡、服务器等产品需求增长。汽车电子继续把握在新能源和 ADAS 方向的机会，需求平稳增长。

**Q3、请介绍公司 2025 年第一季度封装基板业务经营拓展情况。**

公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。具备了包括 WB、FC 封装形式全覆盖的封装基板技术能力。2025 年第一季度，公司封装基板业务需求较去年第四季度有一定改善，主要得益于存储类产品需求提升。

**Q4、请介绍公司 FC-BGA 封装基板产品技术能力及广州封装基板项目爬坡进展。**

公司 FC-BGA 封装基板现已具备 20 层及以下产品批量生产能力，各阶产品相关送样认证工作有序进行。20 层以上产品的技术研发及打样工作按期推进中。

公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力持续提升，产能爬坡稳步推进，已承接 BT 类及部分 FC-BGA 产品的批量订单，但总体尚处于产能爬坡早期阶段，由此带来的成本及费用增加，对公司利润造成一定负向影响。得益于各类订单逐步投入生产，广州封装基板项目在本报告期内亏损环比已有所收窄。

**Q5、请介绍公司泰国工厂投资规模及目前建设进展。**

公司在泰国工厂总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前基础工程建设按期有序推进中，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。泰国工厂将具备高多层、HDI 等 PCB 工艺技术能力，其建设有利于公司进一步开拓海外市场，满足国际客户需求，完善产品在全球市场的供应能力。

**Q6、请介绍公司 PCB 业务近年来扩产规划。**

公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国项目（在建）均设有工厂。一方面，公司通过对现有成熟 PCB 工厂进行技术改造和升级，打开瓶颈，提升产能；另一方面，公司有序推进南通四期项目建设，构建 HDI 工艺技术平台和产能，目前正在推进项目基础工程建设。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。

**Q7、请介绍公司近期经营情况及工厂产能利用率情况。**

公司近期各项业务经营正常，综合产能利用率仍处于相对高位，其中 PCB 业务因目前算力及汽车电子市场需求延续，近期工厂产能利用率保持高位运行；封装基板业务因近期存储领域需求相对改善，工厂产能利用率较 2024 年第四季度有所提升。

**Q8、请介绍公司对美国销售收入的规模，美国关税政策对公司经营可能产生的影响。**

2024 年及 2025 年第一季度，公司对美国直接销售收入占公司营业收入比重较低，公司整体受影响的范围较小。由于相关事项仍在动态演变中，产业链相关各方尚需时间对当前国际经贸环境发生的新变化进行研判并采取行动。公司正保持密切关注，并与产业链各相关方持续进行沟通，共同协商解决方案，做好灵活应对。

**Q9、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。**

公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2025 年第一季度，受大宗商品价格变化影响，金盐等部分原材料价格同比提升、较 2024 年第四季度亦出现一定涨幅。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无